



Jisso をビジネスモデルまで 高めよう

石原 政道*

最近発生したスマトラ島沖地震と巨大“津波”の被害は想像を絶するほどの痛ましい災害であるが、一日も早い復興と人々の平和な日常が取り戻されることを願わざるを得ない。ところでこの“津波”の報道を見ていると、“津波”は国際表現でも“tsunami”である。幾つかの辞書を調べてみたところ、いずれも語源は日本と書いてあるがその由来についての説明はない。辞書では的確な単語はなく英語で分析的に“seismic sea wave: 地震から起こる波”(Random House)と説明している。一方“津波”を百科事典で調べてみると「“津”(港)に突然恐ろしい災害をもたらす“波”」とある。すなわち英語表現では分析的で因果関係を表しているに過ぎないが、“津波”は短い言葉の中にも状況とそれによって引き起こされる結果も表現していると言える。これが国際表現として用いられている理由ではないかと考えている。

同じような理由で“Jisso”と“Assembly”の差があるのではないか。Assemblyとは、ただ、組み立てという行為や結果のみを表すのに対し、Jissoは組み立てに対する工夫や新しい手法までも包含していると思う。そしてこの違いは言葉そのものの差だけでなく、日本人と欧米人の特長の差も表していると考えている。リチャード・E・ニスベットは「木を見る西洋人 森を見る東洋人」(ダイヤモンド社)の中で「日本人は、ものごとを包括的に見て、すべてのものの関係を重視するのに対して、アメリカ人は分析的に見て、重要なものの因果関係を見出そうとする」と述べている。また韓国の女流作家である呉善花氏は講演(平成15年4月7日USフォーラム)の中で「日本は欧米の良いところもアジアの良いところも持っているが、もう1つ日本にしかないものを持っている。それは自然と一体になった感覚である」と言っている。この「ものごとを包括的に見る感覚」や呉善花氏のいう「日本人特有の感覚」が日本のJisso(実装)にも大いに効果的に作用していると考えている。

実装の半導体パッケージ分野をみると、QFP、LOC等、日本生まれのパッケージが世界標準となっており、最近ではSiP(System in Package)やPoP(Package on Package)等、いずれも日本がリードをしていると言っても過言ではない。筆者自身、企業に籍を置いていたときにLSIの設計の立場でLOCパッケージの開発に携わったが、これも日本人の「物事を包括的に見る」という性格が功を奏し、日本しかできなかった実装技術であると自負している。

しかしながらビジネス(金儲け)を考えたとき、果たして“Jisso”が効果を発揮しているだろうか? 答えは“まだ否”である。半導体企業から大学へ籍を移し過去を振り返ると、実装も含め技術面はリードできたと自信を持って言えるが、ビジネスでは必ずしも成功したとは言えず、もっと上手なビジネスモデルを構築するべきであったと反省している。

今後の実装関係の技術では“インクジェットによる配線技術”に注目している。この技術が実用化されれば基板からチップ実装に至るまで大きく世界が変わる可能性がある。これまた日本が大きく先行している技術分野である。筆者自身この技術を活用した「リアルチップサイズ両面電極パッケージ」という新しい実装を追求している。そして新しい技術の開示だけでなく、この技術の上に成り立つビジネスモデルの構築にも大いに貢献したいと考えている。そしてJissoに携わるすべての人が、今まで以上にビジネスモデルまでも考えた取り組みをされることを期待してやまない。